

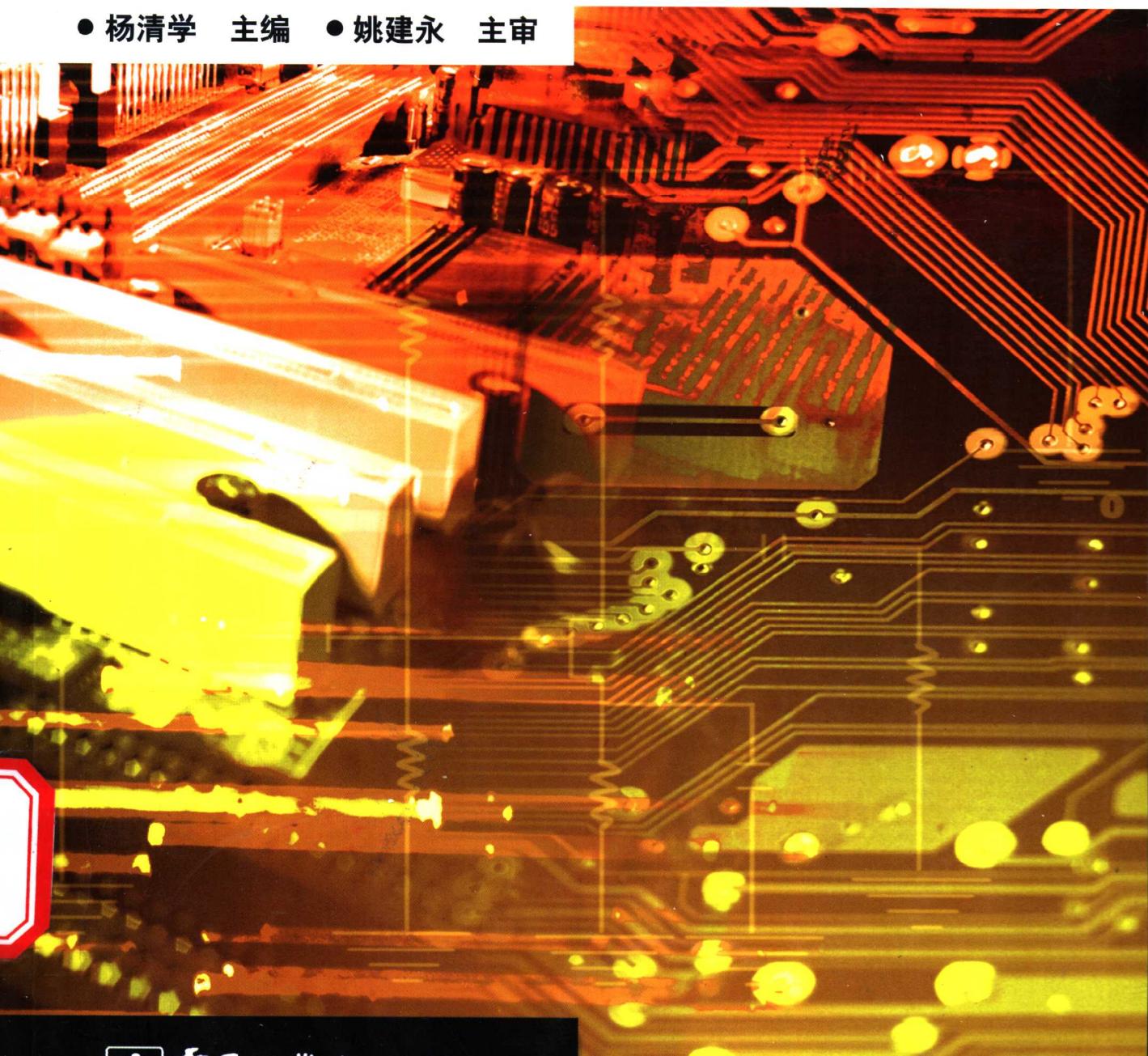
高等职业教育电子信息类贯通制教材

• 电子技术专业



电子装配工艺

• 杨清学 主编 • 姚建永 主审



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

高等职业教育电子信息类贯通制教材（电子技术专业）

电子装配工艺

杨清学 主编

姚建永 主审

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 · BEIJING

内 容 简 介

本书内容包括：常用技术文件及整机装配工艺过程、常用电子材料、常用电子元器件与仪器、电子装配与连接工艺、装配准备工艺基础、电子部件装配工艺、电子整机总装与调试工艺、检验与包装工艺等。章后有小结和习题。本书既强调基础，又力求体现新知识、新技术、新工艺，内容与国家职业技能鉴定规范相结合，注重实践性和学生技能的培养。

本书可作为高职电子与信息专业教材，也可作为有关工程技术人员的参考用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

电子装配工艺/杨清学主编.一北京：电子工业出版社，2003.4

高等职业教育电子信息类贯通制教材

ISBN 7-5053-8220-9

I.电… II.杨… III.电子设备—装配—高等学校：技术学校—教材 IV.TN05

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2003）第 015742 号

责任编辑：刘文杰

特约编辑：王银彪

印 刷：北京兴华印刷厂

出版发行：电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销：各地新华书店

开 本：787×1 092 1/16 印张：12.5 字数：316 千字

版 次：2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

印 数：5 000 册 定价：16.00 元

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系。联系电话：(010) 68279077

前　　言

随着电子技术的飞速发展，电子设备广泛地应用于通信、广播、电视、导航、无线电定位、自动控制、遥控遥测和计算机技术等方面，电子装配工艺也日新月异。本教材编写时，力求突出内容的实用性和新颖性，注重新技术和新工艺的介绍，注重学生技能的培养。考虑到高等职业教育技能训练的特点，教材内容与国家职业技能鉴定规范相结合，以增强学生实验和操作技能，做到理论与实践的统一。

本书共分 8 章。第 1 章常用技术文件及整机装配工艺过程；第 2 章常用电子材料；第 3 章常用电子元器件与仪器；第 4 章电子产品安装和焊接工艺；第 5 章装配准备工艺基础；第 6 章电子部件装配工艺；第 7 章电子整机总装与调试工艺；第 8 章检验与包装工艺。

本书由杨清学主编；李怀甫、熊建云、王刚参加编写；杨清学完成全书的统稿工作；姚建永担任全书的审稿工作。本书在编写过程中，得到四川省电子工业学校、武汉职业技术学院、北京信息职业技术学院、重庆信息职业技术学院等学校领导的大力支持，在此表示感谢。

由于编者水平有限，书中错误和不妥之处在所难免，望广大读者批评指正。

编　者

2002 年 10 月

目 录

第 1 章 常用技术文件及整机装配工艺过程	(1)
1.1 概述	(1)
1.2 常用技术文件	(1)
1.2.1 工艺文件	(1)
1.2.2 工艺文件的格式及填写方法	(2)
1.2.3 设计文件	(11)
1.3 电子整机装配工艺过程	(16)
本章小结	(18)
习题 1	(18)
第 2 章 常用电子材料	(19)
2.1 线材	(19)
2.1.1 线材的分类	(19)
2.1.2 常用线材的主要用途	(20)
2.1.3 线材的选用	(23)
2.2 绝缘材料	(23)
2.2.1 绝缘材料的分类	(23)
2.2.2 常用绝缘材料的性能及用途	(24)
2.3 印制电路板	(25)
2.3.1 覆铜箔板的种类与选用	(25)
2.3.2 印制电路板的特点和分类	(26)
2.4 磁性材料	(27)
2.4.1 磁性材料分类	(27)
2.4.2 常用磁性材料的主要用途	(27)
2.5 辅助材料	(28)
2.5.1 焊料	(28)
2.5.2 助焊剂	(29)
2.5.3 阻焊剂	(31)
2.5.4 黏合剂	(31)
本章小结	(33)
习题 2	(33)
第 3 章 常用电子元器件与仪器	(34)
3.1 电阻器	(34)
3.1.1 电阻器概述	(34)
3.1.2 电阻器主要技术参数	(35)
3.1.3 电阻器的标识	(36)
3.1.4 可变电阻器	(37)
3.1.5 电阻器的检测与选用	(38)
3.2 电容器	(38)
3.2.1 电容器概述	(38)
3.2.2 电容器的主要技术参数	(38)
3.2.3 电容器的标识法	(39)

3.2.4 可变电容器和微调电容器	(40)
3.2.5 电容器的检测与选用	(40)
3.3 电感元件	(42)
3.3.1 电感线圈	(42)
3.3.2 变压器	(43)
3.4 半导体器件	(44)
3.4.1 半导体二极管	(44)
3.4.2 晶体三极管	(45)
3.4.3 场效应晶体管	(46)
3.4.4 单结晶体管	(47)
3.4.5 晶闸管	(47)
3.4.6 光电器件	(49)
3.5 集成电路 (IC)	(50)
3.5.1 集成电路的种类	(50)
3.5.2 集成电路的封装	(51)
3.5.3 集成电路的使用常识	(51)
3.6 电声器件及磁头	(53)
3.6.1 扬声器	(53)
3.6.2 传声器	(54)
3.6.3 磁头	(55)
3.7 其他元器件	(56)
3.7.1 表面安装元器件	(56)
3.7.2 开关和接插件	(57)
3.7.3 继电器	(59)
3.7.4 霍尔集成电路	(60)
3.7.5 显示器件	(61)
3.8 常用仪器、仪表	(63)
3.8.1 万用表	(63)
3.8.2 直流稳压电源	(67)
3.8.3 电子电压表	(70)
3.8.4 示波器	(71)
3.8.5 信号发生器	(75)
3.8.6 频率特性测试仪	(77)
本章小结	(79)
习题 3	(79)
第 4 章 电子产品安装和焊接工艺	(81)
4.1 常用工具	(81)
4.1.1 焊接工具	(81)
4.1.2 钳口工具	(83)
4.1.3 剪切工具	(84)
4.1.4 紧固工具	(85)
4.2 常用设备	(87)
4.2.1 普通浸锡炉	(87)
4.2.2 波峰焊接机	(87)
4.2.3 自动插件机	(88)

4.2.4 烫印机	(88)
4.2.5 表面安装工艺装备	(89)
4.3 焊接工艺	(92)
4.3.1 焊接的基本知识	(93)
4.3.2 焊接的操作要领	(94)
4.3.3 拆焊	(96)
4.3.4 自动焊接	(98)
4.4 表面安装技术(SMT)	(101)
4.4.1 表面安装技术的特点	(101)
4.4.2 SMT 的基础材料	(101)
4.4.3 SMT 工艺流程	(102)
4.5 其他连接工艺	(105)
4.5.1 胶接工艺	(105)
4.5.2 紧固件连接工艺	(106)
4.5.3 无锡焊接工艺	(108)
4.5.4 接插件连接工艺	(111)
本章小结	(111)
习题 4	(112)
第 5 章 装配准备工艺基础	(113)
5.1 导线加工工艺	(113)
5.1.1 绝缘导线加工工艺	(113)
5.1.2 屏蔽导线端头的加工工艺	(115)
5.2 元器件引线成形	(116)
5.2.1 元器件引线成形的技术要求	(117)
5.2.2 元器件引线成形方法	(117)
5.3 线扎制作	(118)
5.3.1 线扎的要求	(118)
5.3.2 线扎制作方法	(119)
本章小结	(122)
习题 5	(122)
第 6 章 电子部件装配工艺	(123)
6.1 印制电路板的组装工艺	(123)
6.1.1 印制电路板组装工艺流程和要求	(123)
6.1.2 印制电路板元器件的插装	(124)
6.1.3 印制电路板表面贴装技术	(128)
6.1.4 印制电路板的清洗	(131)
6.1.5 印制电路板的检测	(132)
6.2 面板、机壳装配工艺	(132)
6.2.1 塑料面板、机壳的加工工艺	(133)
6.2.2 面板、机壳的装配	(135)
6.3 散热件、屏蔽装置的装配工艺	(135)
6.3.1 散热件的装配	(135)
6.3.2 散热器的装配要求	(136)
6.3.3 屏蔽装置的装配	(136)
本章小结	(138)

习题 6	(139)
第 7 章 电子整机总装与调试工艺	(142)
7.1 电子整机总装工艺	(142)
7.1.1 电子整机总装概述	(142)
7.1.2 大屏幕彩色电视机生产工艺流程	(146)
7.2 整机调试工艺	(157)
7.2.1 概述	(157)
7.2.2 调试工作的内容	(157)
7.2.3 调试方案的制定	(157)
7.2.4 调试、测试仪器、仪表的选配与使用	(158)
7.2.5 调试工艺	(160)
7.2.6 调试的安全措施	(164)
7.2.7 小型电子整机调试举例	(164)
7.2.8 29 英寸彩色电视机整机调试举例	(167)
本章小结	(168)
习题 7	(169)
第 8 章 检验与包装工艺	(168)
8.1 检验	(168)
8.1.1 检验的基本知识	(168)
8.1.2 产品检验	(170)
8.1.3 例行试验	(172)
8.2 包装工艺	(174)
8.2.1 包装概述	(174)
8.2.2 包装材料	(176)
8.2.3 条形码与防伪标志	(177)
8.2.4 电子整机包装工艺	(178)
本章小结	(179)
习题 8	(180)
附录 A 常用电阻器、电容器的型号命名	(181)
附录 B ISO 9000 系列质量标准	(183)
附录 C 半导体器件的型号命名	(185)
附录 D 半导体集成电路的型号命名	(188)
参考文献	(190)

第1章 常用技术文件及整机装配工艺过程

1.1 概述

随着电子技术的发展，电子设备正广泛地应用于人类生活的各个领域。按用途可分为通信、广播、电视、导航、无线电定位、自动控制、遥控遥测和计算机技术等方面的设备。随着电子设备的使用范围越来越广，使用条件越来越复杂，质量要求越来越高，因此对电子产品结构的要求也越来越高。对整机结构的基本要求如下：结构紧凑，布局合理，能保证产品技术指标的实现；操作方便，便于维修；工艺性能良好，适合大批量生产或自动化生产；造型美观大方。而电子产品的生产与发展和电子装配工艺的发展密切相关，任何电子设备，从原材料进厂到成品出厂，要经过千百道工序的生产过程。生产过程中，大量的工作是由具有一定技能的工人，操作一定的设备，按照特定的工艺规程和方法去完成的。

电子整机装配工艺常用技术文件分为设计文件和工艺文件两大类，它们是整机产品生产过程中的基本依据。

设计文件是产品在研究、设计、试制和生产过程中积累而形成的图样及技术资料，它规定了产品的组成形式、结构尺寸、原理以及在制造、验收、使用、维护和修理时所必须有的技术数据和说明，是组织生产的基本依据。

工艺文件是根据设计文件、图纸及生产定型样机，结合工厂实际，如工艺流程、工艺装备、工人技术水平和产品的复杂程度而制定出来的文件。它以工艺规程（即通用工艺文件）和整机工艺文件的形式，规定了实现设计图纸要求的具体加工方法。工艺文件是工厂组织、指导生产的主要依据和基本法规，是确保优质、高产、多品种、低消耗和安全生产的重要手段。

电子整机装配工艺过程可分为装配准备、装联（包括安装和焊接）、总装、调试、检验、包装、入库或出厂几个环节。

1.2 常用技术文件

1.2.1 工艺文件

1. 编制工艺文件的原则

编制工艺文件应在保证产品质量和有利于稳定生产的条件下，以最经济、最合理的工艺手段进行加工为原则。

编制工艺文件的原则有以下几点：

(1) 编制工艺文件，要根据产品批量的大小、技术指标的高低和复杂程度区别对待。对于一次性生产的产品，可根据具体情况编写临时工艺文件或参照借用同类产品的工艺文件。

- (2) 编制工艺文件要考虑到车间的组织形式、工艺装备以及工人的技术水平等情况，必须保证编制的工艺文件切实可行。
- (3) 对于未定型的产品，可以编写临时工艺文件或编写部分必要的工艺文件。
- (4) 工艺文件以图为主，力求做到容易认读、便于操作，必要时加注简要说明。
- (5) 凡属装调工应知应会的基本工艺规程内容，可以不再编入工艺文件。

2. 编制工艺文件的要求

- (1) 工艺文件要有统一的格式、统一的幅面，图幅大小应符合有关标准，并装订成册，配齐成套。
- (2) 工艺文件的字体要正规、书写要清楚、图形要正确。工艺图上尽量少用文字说明。
- (3) 工艺文件所用的产品名称、编号、图号、符号、材料和元器件代号等，应与设计文件一致。
- (4) 编写工艺文件要执行审核、会签、批准手续。
- (5) 线扎图尽量采用 1:1 的图样，并准确地绘制，以便于直接按图纸做排线板排线。
- (6) 工序安装图可不必完全按实样绘制，但基本轮廓应相似，安装层次应表示清楚。
- (7) 装配接线图中的接线部位要清楚，连接线的接点要明确。内部接线可假想移出展开。

3. 工艺图样管理及工艺纪律

- (1) 经生产定型或大批量生产产品的工艺文件底图必须归档，由企业技术档案部门统一管理。
- (2) 对归档的工艺文件的更改应填写更改通知单，执行更改会签、审核和批准手续后交技术档案部门，由专人负责更改。技术档案部门应将更改通知单和已更改的工艺文件蓝图及时通知有关部门，并更换下发的蓝图。更改通知单应包括涉及更改的内容。
- (3) 临时性的更改也应办理临时更改通知单，并注明更改所适用的批次或期限。
- (4) 有关工序或工位的工艺文件应发到生产工人手中，操作人员在熟悉操作要点和要求后才能进行操作。
- (5) 应经常保持工艺文件的清洁，不要在图纸上乱写乱画，以防止出现错误。
- (6) 遵守各项规章制度，注意安全、文明生产，确保工艺文件的正确实施。
- (7) 发现图纸和工艺文件中存在的问题，及时反映，不要自作主张随意改动。
- (8) 努力钻研业务，提高操作技术。积极提出合理化建议，不断改进工艺，提高产品质量。

1.2.2 工艺文件的格式及填写方法

现将常用工艺文件的格式及其填写方法简介如下。

1. 封面

工艺文件封面在工艺文件装订成册时使用。简单的设备可按整机装订成册，复杂设备可按分机单元组建成若干册。按“共 X 册”填写工艺文件的总册数；“第 X 册”填写该册在

全套工艺文件中的序号；“共 X 页”填写该册的总页数；“型号”、“名称”、“图号”分别填写产品型号、名称、图号；“本册内容”填写该册工艺内容的名称；最后执行批准手续，并填写批准日期。

工艺文件封面格式如表 1.1 所示。

表 1.1 工艺文件封面格式

工 艺 文 件	
型 号	共 第 共 册 册 页
名 称	
图 号	
本册内容	
批 准 年 月 日	

2. 工艺文件目录

工艺文件目录是供装订成册的工艺文件编写目录用的，反映产品工艺文件的齐套性。填写中，“产品名称或型号”，“产品图号”与封面的型号、名称、图号保持一致；“拟制”、“审核”栏内由有关职能部门签署姓名和日期；“更改标记”栏内填写更改事项；“底图总号”栏内，填写被本底图所代替的旧底图总号；“文件代号”栏填写文件的简号，不必填写文件的名称；其余各栏按标题填写，填写零部件、整件的图号、名称及其页数。

工艺文件目录格式如表 1.2 所示。

表 1.2 工艺文件目录格式

3. 工艺路线表

工艺路线表为产品的整件、部件、零件在加工准备过程中做工艺路线的简明显示用，供企业有关部门作为组织生产的依据。填写中，“装入关系”栏以方向指示线显示产品零件、整件的装配关系；“部件用量”、“整件用量”栏，填写与产品明细表对应的数量；“工艺路线及内容”栏，填写整件、部件、零件加工过程中各部门（车间）及其工序名称和代号。

工艺路线表格式如表 1.3 所示。

表 1.3 工艺路线表格式

4. 导线及扎线加工表

导线及扎线加工表供导线及扎线加工准备及排线时使用。填写中，“编号”栏填写导线的编号或扎线图中导线的编号；“名称规格”、“颜色”、“数量”栏填写材料的名称规格、颜

色、数量；“长度”栏中的“全长”、“A 端”、“B 端”、“A 剥头”、“B 剥头”，分别填写导线的开线尺寸、扎线 A、B 端的甩端长度及剥头长度；“去向、焊接处”栏填写导线焊接去向。

导线及扎线加工表格式如表 1.4 所示。

表 1.4 导线及扎线加工表格式

5. 配套明细表

编制配套用的零部件、整件及材料与辅助材料清单，供各有关部门在配套及领、发料时用。填写中，“图号”、“名称”、“数量”栏填写相应的整件设计文件明细表的内容；“来自何处”栏填写材料来源处；辅助材料填写在顺序的末尾。

配套明细表格式如表 1.5 所示。

表 1.5 配套明细表格式

6. 装配工艺过程卡

装配工艺过程卡格式如表 1.6 所示。

表 1.6 装配工艺过程卡格式

装配工艺过程卡是整机装配中的重要文件，它反映装配工艺的全过程，供机械装配和电气装配时使用。填写中“装入件及辅助材料”中的“名称、牌号、技术要求”、“数量”栏应按工序填写相应设计文件的内容，辅助材料填在各道工序之后；“工序（工步）内容及要求”栏填写装配工艺加工的内容和要求；空白栏处供画加工装配工序图时使用。

7. 工艺说明及简图

工艺说明及简图格式如表 1.7 所示。

表 1.7 工艺说明及简图格式

				工艺说明及简图		名 称		编 号或图 号								
				工 序 名 称		工 序 编 号										
使 用 性																
旧底图总号																
底图总号		更 改 标 记	数 量	文 件 号	签 名	日期	签 名	日期	第 页							
							拟 制									
							审 核		共 页							
日 期	签 名															
									第 册	第 页						

工艺说明及简图可做任何一种工艺过程的续卡，供画简图、表格及文字说明用；也可用做编写调试说明、检验要求及各种典型工艺文件等。

8. 工艺文件更改通知单

工艺文件更改通知单格式如表 1.8 所示。